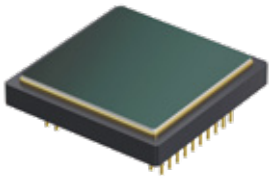


陶瓷封装非制冷 红外探测器

■ 高性价比红外芯片解决方案



产品介绍：

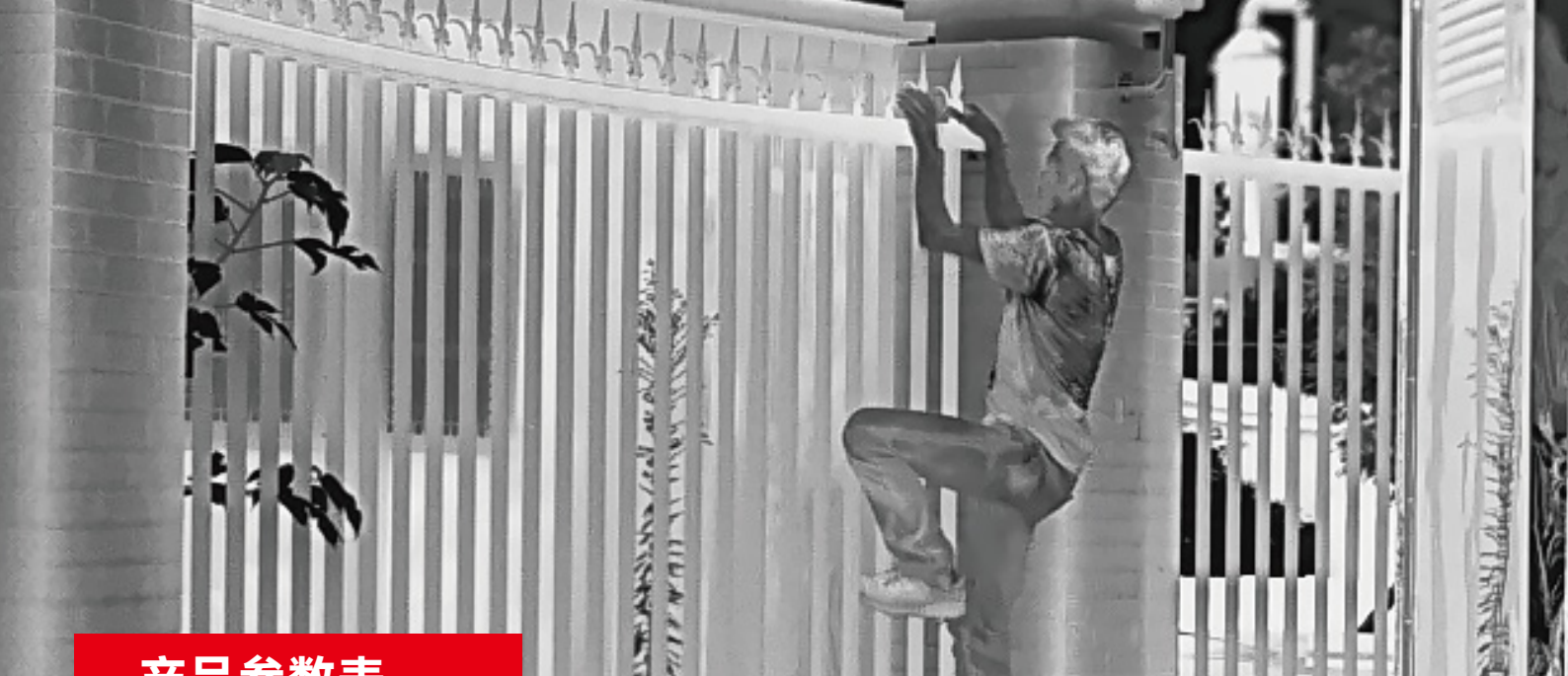
GST412C、GST612C采用陶瓷封装技术、无TEC设计，集性能高、功耗低、体积小、重量轻、可靠性高等优势于一体，以更高的性价比优势为用户带来更佳的红外成像体验。

满足高性能应用需求

- 探测灵敏，NETD < 40mK
- 成像优质，画质流畅，帧频高达50Hz

满足小型化集成需求

- 尺寸紧凑，低至18.5×18.5×3.8 mm（不计引脚尺寸）
- 重量轻，轻至4.5g
- 功耗低，GST612C功耗低至120mW，GST412C功耗低至80mW



产品参数表

产品型号	GST612C	GST412C
敏感材料	氧化钒	
阵列规格	640×512	400×300
像元间距	12μm	12μm
响应波段	8-14μm	
典型NETD	<40mK	
输出信号	内置14位ADC	
热响应时间	<12ms	
最大帧频	50Hz	
功耗	≤120mW	≤80mW
尺寸(mm)	18.5×18.5×3.8 (不计引脚尺寸)	
重量	<4.5g	
工作温度	-40°C ~ +85°C	

规格如有变更，恕不另行通知

武汉高芯科技有限公司

☎ 400-027-0198

✉ marketing@gst-ir.com

🌐 www.gst-ir.com

📍 湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号,430205

